

证券代码：300757

证券简称：罗博特科

罗博特科智能科技股份有限公司投资者关系活动记录表

编号：2024-02

投资者关系活动类别	<input checked="" type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（电话会议）
参与单位名称及人员姓名	申万宏源 李蕾、李冲、李国盛 申万资管 吴悠 泾溪投资 方彦 农银汇理 高晗 国泰人寿 曾少聪 星石投资 杨英 宏道投资 段然 东方财富证券 杨安东、唐硕 中银基金 张婧妍 汇丰前海证券 郑冰仪 瑞腾投资 丛晓龙
时间	2024年3月1日 10:00-11:10
地点	公司 A 栋四楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事会秘书 李良玉女士
投资者关系活动主要内容介绍	<p>一、公司介绍</p> <p>董事会秘书李良玉女士向全体参加调研人员就公司经营情况、战略规划等进行了简单介绍。</p> <p>二、问题交流</p> <p>1、ficonTEC 的收购进展如何？</p> <p>答复：公司于 2024 年 1 月 31 日收到深交所的通知，公司因重大资产重组申请文件中记载的财务资料已过有效期，需要补充提交。按照《深圳证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的相关规定，深交所对公司本次重组中止审核；2024</p>

年 2 月 27 日，公司完成对本次交易申请文件中记载的财务资料的更新工作，并向深交所提交了恢复审核的申请；2024 年 2 月 28 日，公司收到深交所同意恢复本次交易审核的回复。具体情况详见公司已经披露的相关公告。目前公司本次重大资产重组申请文件正在深交所正常审核进程中，公司将按照法律法规的规定及时披露相关进展，敬请关注相关公告。

2、请李总谈谈对 ficonTEC 未来 3-5 年的战略布局，目前在全球的客户主要有哪些？

答复：在战略布局方面，ficonTEC 是全球化的战略布局。总体来说，国内、外对硅光及 CPO 布局的切入时间、投入度和迫切度有一定的差别，国外尤其是美、欧相比国内的布局更早，进展相对更快，量级也会更大；ficonTEC 更侧重于硅光及 CPO 方向所需的更高精度要求的全自动高端封测设备，而不是基于传统光模块工艺生产制造模式下对应的设备，从现在技术革新的方向看，随着 AI 军备竞赛的开启大幅拉动了算力的爆发式需求，具有更高集成度要求，满足未来在光电子、光通信领域高带宽、低功耗、低成本的硅光及 CPO 技术正在加速发展。公司也在积极推进关于本次交易的审核进程相关工作，完成本次重组交易后，公司关于该板块的业务规划方向将按照“双总部”布局的思路，推动落实国内产能建设，提升产能匹配能力及运营效率，从而匹配全球范围内的客户需求。具体情况详见公司已披露的《罗博特科智能科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)(修订稿)》相关内容。

在客户方面，ficonTEC 拥有众多国内外客户，包括 Intel、Cisco、Broadcom、NVIDIA、Ciena、Finisar、nLight、Lumentum、Velodyne、Infineon、华为等一批全球知名的半导体、光通讯、激光雷达等行业的龙头企业客户，有良好的客户资源优势。

3、ficonTEC 最新的在手订单情况如何？其中英伟达的订单有多少？

答复：截至 2024 年 1 月 31 日，ficonTEC 的在手订单金额约为 5,765 万欧元，其中英伟达的订单约为 1,007.64 万欧元。具体明细情况详见公司已经披露的草案修订稿及后续相关公告。

4、请简单介绍一下 ficonTEC 未来的产能规划。

答复：在未来产能的规划方面，一方面 ficonTEC 会根据下游客户的需求来做一定的产能规划；另一方面，我们会积极推动重组并购事项的落地，力求在重组并购事项完成后加快中国总部研发、生产、服务团队建设，快速实现国产化落地，通过国产化降低生产成本，并发挥地域优势服务亚太客户，对中端产品线进行覆盖。同时，利用国产化迅速提升产能，支撑全球业务增长。

5、ficonTEC 设备的核心技术和竞争优势在哪？

答复：ficonTEC 的核心技术和竞争优势包括：（1）自主研发的核心运动控制及工艺算法软件，自主可控的超高精密运动平台。ficonTEC 具备自主的精密运动控制设计及制造技术，其设备中精密运动的 3 轴耦合引擎、6 轴耦合引擎由 ficonTEC 自研，直线运动精度可以达到 5 纳米，角精度 2 秒(1/1800 度)；（2）先进的定位和视觉系统及机器学习算法，可确保光学器件的高精度快速耦合。ficonTEC 通过特有的 Auto Align 多轴校准和定位技术，结合多相机系统视觉算法，能够实现硅光芯片封装过程中对微小光学元器件进行精准定位，提供纳米级高精度光器件耦合。利用上述技术，ficonTEC 亦可在光芯片贴装、激光焊接过程中提供高精度点胶、耦合等。同时，在光电

测试应用中，ficonTEC 能够提供高精度、高效率的垂直光栅耦合和边缘耦合方法，实现芯片至晶圆级的光电器件光学与电学性能的自动化测试；（3）“从定制化到标准化-从实验室到大规模量产”的业务模式保证了与客户的持续合作；（4）与国际知名研究机构的前瞻性研发合作是公司保持领先的基础；（5）丰富的设备定制化设计经验是公司产品从定制到标准化的保证。ficonTEC 长期从事光电子器件封装检测设备的研发和生产，在全球范围内累计交付了超过 1,000 套系统，涵盖各个类型的封装检测设备，积累了丰富的设计方面的经验。

6、铜电镀项目的进展如何？预计什么时候可以获得量产订单？产化后的价格会如何？

答复：公司与国电投双方将在二阶段测试指标基本达到协议指标的基础上继续优化；2023 年 6 月 13 日单体 GW 级铜电镀设备发到合作客户方后，8 月底前，完成了第一阶段工艺验证，电池片 A 级良率数据不断提升，初步指标超预期，9 月初开始正式切入第二阶段测试，截至目前收集到的相关数据，第二阶段测试已初步完成，结果较为理想；2023 年 12 月初，公司向另一家光伏电池片的头部企业出货单体 GW 级铜电镀设备，今年年初设备已经完成安装调试，目前设备已完成首次出片，出片指标基本符合公司与合作客户方预期，双方在积极推进下一步的测试验证工作。铜电镀设备量产化的时间主要取决于两个方面，一方面取决于公司及合作客户方各自测试部分的进度，包括公司对自动化设备指标的测试（产能、碎片率等）及合作客户方对工艺部分的测试（电解液配方等）；另一方面取决于客户端对铜电镀设备量产化的整体安排，公司将携手客户方实现电镀工艺设备与自动化设备的全面对接，确保整条生产线的顺畅运行，收集量产数据，并持续优化工艺方案，全面验证设备量产指标情况，为公司打造新的业绩增长点。

	公司铜电镀设备的定价需要综合考虑市场需求、市价水平、产品成本、研发投入以及客户定制化要求等多方面因素来综合确定。
关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明	无
附件清单(如有)	无
日期	2024年3月1日